

原子論的生産技術の創出とその深化

半導体材料表面先端加工技術の紹介

開催日時 2023年

3月31日 Fri

セミナー 12:30 ▶ 16:40
装置見学会 (12:00 開場・受付開始)

懇親会 16:40 ▶ 18:00

開催場所

ジェイテックコーポレーション
本社 4F 会議室
大阪府茨木市彩都やまぶき 2-5-38

参加費用 無料



開会挨拶 12:30 ▶ 12:45

株式会社ジェイテックコーポレーション 取締役 営業部長 金岡 政彦

セミナー 12:45 ▶ 15:55

12:45 ▶ 13:30 大阪大学 大学院工学研究科 物理学系専攻
精密工学コース 超精密加工領域
教授 山内 和人 先生

13:30 ▶ 14:15 大阪大学 工学研究科附属精密工学研究センター
大学院工学研究科物理学系専攻
精密工学コース ナノ製造科学領域
センター長 / 教授 山村 和也 先生

「触媒反応を援用した光学材料、半導体材料表面の
超平滑化エッチング法 (CARE※)」
※CAlyst Referred Etching

「プラズマ/電気化学プロセスを用いたナノ精度の
形状加工と難加工材料の高エネルギーダメージフリー研磨」

14:15 ~ 14:25 休憩

14:25 ▶ 15:10 大阪大学 大学院工学研究科 物理学系専攻
精密工学コース 超精密加工領域
准教授 佐野 泰久 先生

15:10 ▶ 15:55 立命館大学
理工学部 機械工学科
准教授 村田 順二 先生

「大気圧プラズマを用いたプラズマエッチング
(PCVM※)による半導体表面の精密加工」
※Plasma Chemical Vaporization Machining

「電解液を用いない電気化学的表面創成」

装置見学会 16:00 ▶ 16:40

装置見学会終了後、懇親会 (16:40 ~) を開催いたします。(参加費無料)